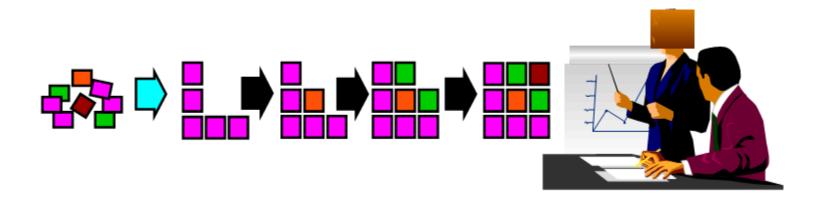
CMMI L3 PI 产品集成过程域 Product Integration

上海静脉信息科技

产品集成目的

把产品构件组装成产品,确保所集成的产品满足功能和 质量属性要求,并交付产品

分解的逆向是集成



SG1及其特定实践

特定目标 SG1 准备产品集成: 为产品集成做准备 特定实践

SP1.1建立一个集成策略

SP1.2建立产品集成环境

SP1.3建立产品集成规程和准则



SP1.1建立一个集成策略

建立和维护一个产品集成策略

- 产品集成策略描述了如何接受、集成、评价产品组件的方法, 通常包括:
 - 确保待集成的组件可用
 - 确定集成方式(顺序):一次性集成或者增量集成
 - 当使用迭代开发方式时,每次迭代包含哪些特性,如何测试这些特性
 - 如何评价集成后的产品
 - 准备集成需要的软硬件环境、包括集成测试的环境
 - 集成的步骤和准则

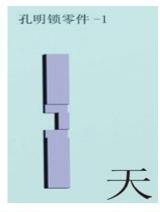
什么时候确定集成顺序?

- 在把系统分解为模块的同时,就要 考虑怎么样把它们集成起来
- 考虑模块间的先后关系 如: A模块是B模块的基础

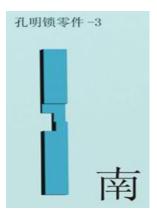


#为什么要考虑集成顺序

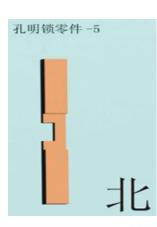
孔明锁

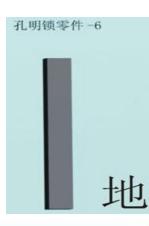














将1号和2号 交叉搭接。注 意2号零件的方 向。



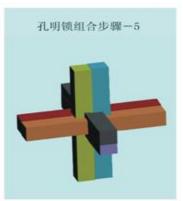
在步骤1的 交叉体中,插 入3号零件。注 意3号零件是有 方向性的。



在步骤2的 交叉体中,扣 入4号零件。



在步骤3的 交体叉中,插 入5号零件。注 意5号零件是有 方向性的。



在步骤4的 交叉体中,穿 过前五个零件 形成的方孔, 插入6号零件。

SP1.2建立产品集成环境

建立和维护支持产品构件集成的环境

- 建立产品集成环境首先考虑是否能够复用已有的环境,如果不能复用再考虑购买或开发集成环境
- 集成的环境可能包括:
 - 开发、编译的工具
 - 集成测试的工具
 - 集成时的软硬件要求,如:配置服务器,配置网络环境

SP1.3建立产品集成规程和准则

建立和维护产品构件集成的规程和准则

- 集成规程通常在组织级定义,项目级可裁剪:
 - 集成规程指集成、集成测试活动具体的操作细节
- 集成的准则一般在组织级定义,项目级可裁剪,通常包括:
 - 入口准则,如:所有模块均通过模块测试
 - 出口准则,如:
 - 当执行非正式的集成测试时的准则:集成编译没有错误,并且做了冒烟测试,保证主要功能够跑通;
 - 当执行正式的集成测试时的准则:集成测试用例覆盖了所有接口并执行通过,发现的问题全部改正

规程和准则指导我们如何做集成



SG2及其特定实践

特定目标 SG2 确保接口兼容: 确保产品构件的接口 (内部接口和外部接口) 都是兼容的 特定实践

SP2.1评审接口描述的完整性

SP2.2管理接口

SP2.1评审接口描述的完整性

评审接口描述,确保覆盖全面并且完整

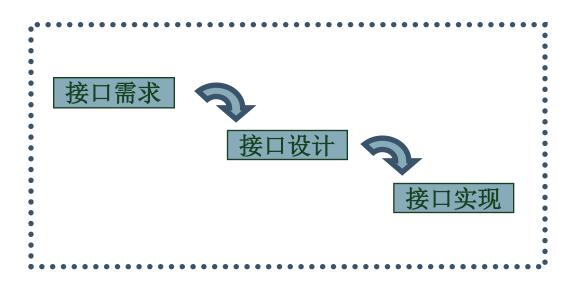
- 集成的问题就是接口的问题
- 内外部接口定义需要经过相关人员的评审,确保一致

接口描述在哪些文档中体现?

- 产品规格说明书
- 框架设计说明书
- 模块详细设计说明书
- 专门的接口规格文档

SP2.2管理接口

管理产品和产品构件的内外部接口定义、设计和变更





接口变更要走变更流程!



SG3及其特定实践

特定目标 SG3 集成产品构件并 交付产品:集成经过验 证的产品构件,交付经 过集成、验证、确认的 产品 特定实践

SP3.1确认集成用的产品构件 已经准备就绪

SP3.2组装产品构件

SP3.3评价组装的产品构件

SP3.4包装并交付产品或产品 构件

SP3.1确认集成用的产品构件已经准备就绪

在组装前,确认每一个待组装的产品构件都被标识,功能和质量属性都满足要求,构件间的接口和接口描述一致

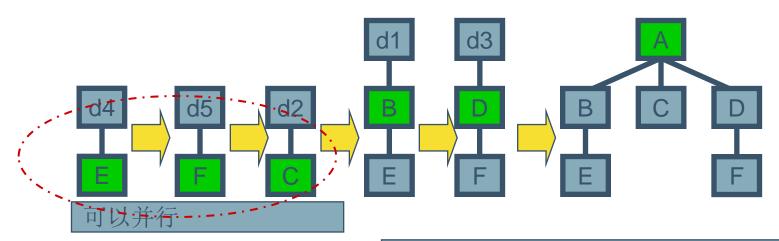
- 集成前要确认各个模块均通过测试;
 - 单元测试、代码评审
 - 模块测试
- 对于外购构件必须有验收报告

SP3.2组装产品构件

根据产品集成策略和步骤组装产品构件

- 按集成策略中定义的集成顺序、集成步骤进行集成
- 软件项目的集成通常是按照集成顺序进行集成编译、构建
 - <u>自底向上的集成</u>:先开发底层模块,再依次向上开发主模块,直到所有模块集成完毕
 - 自顶向下的集成: 先开发主模块(主架构),在逐个集成底层模块
 - 一次性集成: 所有模块开发完毕后一次性进行集成

#自底向上方式

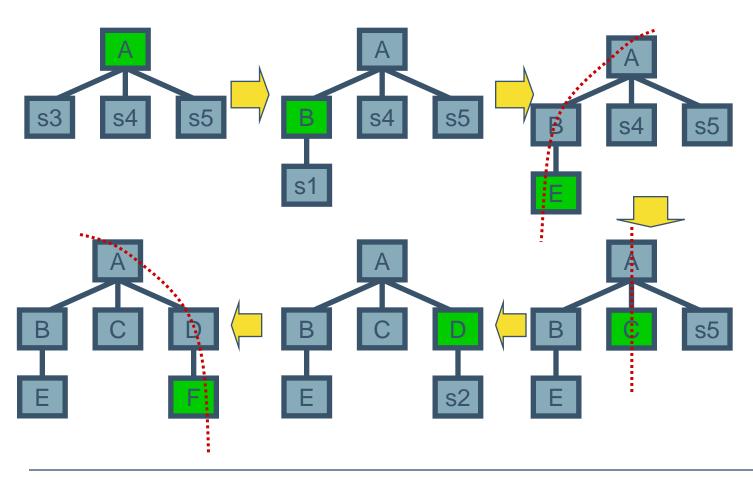


混合方式测试策略

- 自顶向下与自底向上混合使用
- 首先测试关键模块
 - 较高层次模块
 - 较复杂,易发生错误模块
 - 有性能要求模块

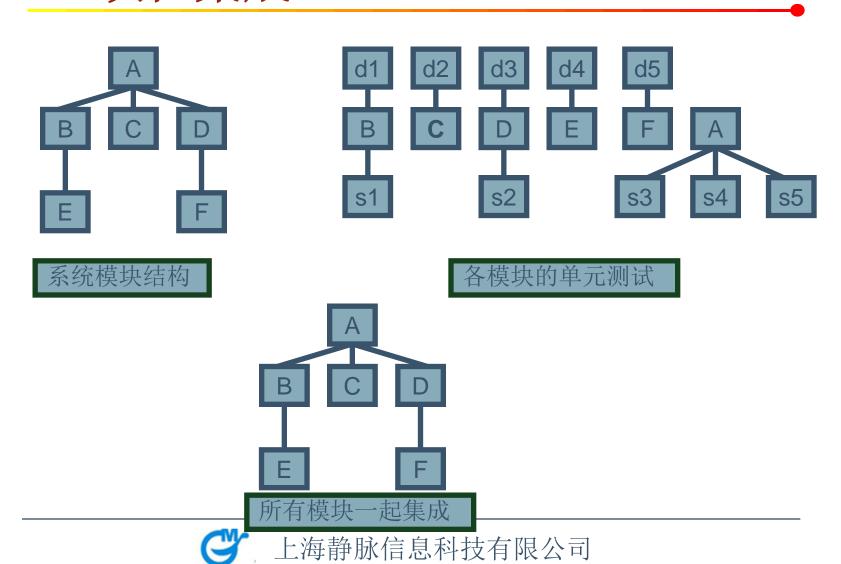


#自顶向下方式(深度优先)





#一次性集成



#集成的粒度

集成的粒度可大可小

- 1个人负责的几个模块之间的集成
- 2个人负责的模块之间的集成
- 1个小组与另一个小组之间的集成
- 1个项目与另一个项目之间的集成

集成粒度不同,对集成的控制程度不同

SP3.3评价组装的产品构件

评价组装的产品构件间的接口兼容性

- 集成测试有两种方式:
 - 一边集成,一边测试
 - 待所有组件集成后,统一测试
- 集成测试关注点
 - 接口正确性
 - 集成后的模块间的协作功能正确性
 - 模块间的相互影响
 - 全局数据结构是否有问题
 - 误差是否会放大



#注意

- 很多时候正式的集成测试由测试人员完成, 开发人员仅仅集成编译通过, 并做了简单的冒烟测试。
- 测试人员的集成测试
 - 一边集成,一边测试: 首先测试单个模块,当两个模块间有 关系时,就会做两个模块的集成测试
 - 待所有组件集成后,统一测试:和系统测试合并进行,但是需要设计能够测试到模块间接口的测试用例,有时候系统测试用例隐含的测试了模块间的接口

SP3.4包装并交付产品或产品构件

包装组装的产品或产品构件并交付给客户

交付给最终用户

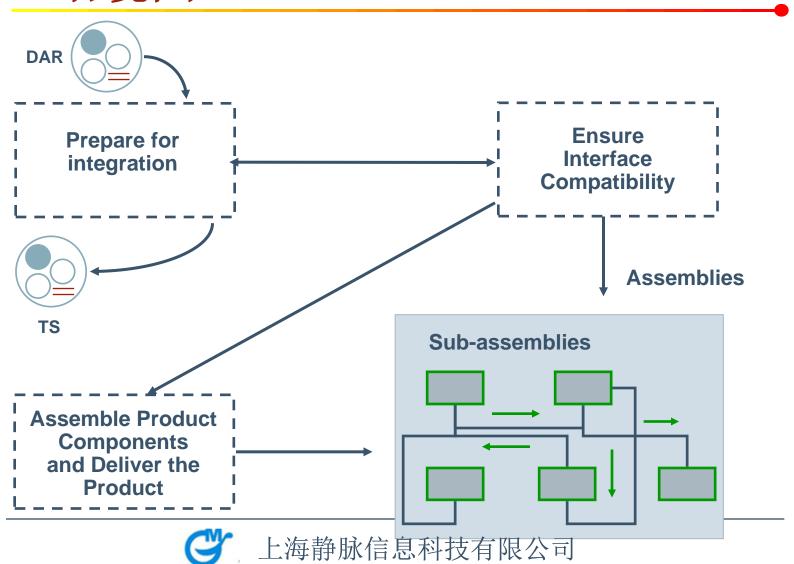
- 交付前的准备
 - 交付、安装、操作环境要部署好
 - 评审需求、设计、产品、测试结果,确保打包交付的 顺利进 行
- 交付的方式
 - 直接部署软件/产品到用户的使用环境中,由用户试运行或验收
 - 把可执行程序、安装手册、使用手册等通过光盘、网络传输、 用户网络下载等方式给用户
- 交付的内容
 - 打包的可执行程序、用户手册等支持文档
 - 合同或用户要求的其它文档



#交付给测试组

- 交付前的准备
 - 测试环境要部署好
 - 通过集成编译和测试,保证整个系统能够顺畅运行 (一般通过冒烟测试,保证系统主要功能能够跑通)
- 交付的方式
 - 直接部署软件/产品到测试环境中,由测试人员试进 行测试
- 交付的内容
 - 打包的可执行程序、用户需求文档、用户手册等支持 文档;有时候用户手册还没产出,需要测试人员在测 试的时候或测试后撰写.

PI语境图



内容回顾

目的

把产品构件组装成产品,确保 所集成的产品满足功能和质量 属性要求,并交付产品。

特定目标

SG1 准备产品集成: 为产品集成 做准备。

SG2 确保接口兼容: 确保产品构件的接口(内部接口和外部接口)都是兼容的。

SG3 集成产品构件并交付产品: 集成经过验证的产品构件,交付经 过集成、验证、确认的产品。

特定实践

SP1.1建立一个集成策略

SP1.2建立产品集成环境

SP1.3建立产品集成规程和准则

SP2.1评审接口描述的完整性

SP2.2管理接口

SP3.1确认集成用的产品构件已经 准备就绪

SP3.2组装产品构件

SP3.3评价组装的产品构件

SP3.4包装并交付产品或产品构件



问题与回答

